



寬能隙元件在 AI 時代的角色

Wide-Bandgap Devices in the AI Era



時間/Date

115/11/20 (星期五)

November 20, 2026 (Friday)

地點 / Venue

中央大學教研大樓 「羅家倫講堂」

Lo Chia-Lun Lecture Hall, Teaching & Research Building,
National Central University

AGENDA / 活動議程

時間 / TIME	講題 / SESSION	講者 / SPEAKERS
08:30-09:00	Registration	
09:00-09:10	Opening Remarks	綦振瀛 副校長
09:10-09:50	資料中心解決方案、先進冷卻和人工智慧運算	緯穎科技服務股份有限公司 龐景德 資深總監
09:50-10:30	AI Server Power Delivery for High-Performance Computing	台達電子 PSBG 電源及系統事業群 先進產品與技術部 經理 王超駿 博士
10:30-10:50	Coffee Break	
10:50-11:30	Power Innovation: GaN for AI Data Centers	Efficient Power Conversion (EPC) FAE Director, EPC Asia 黃培城 總監
11:30-12:10	GaN Power Electronics Manufacturing for AI Infrastructure	世界先進積體電路股份有限公司 沈士強 處長
12:10-13:00	午餐	
13:00-13:40	GaN 模組於高功率電源供應器應用 Applications of GaN Modules for High-Power Power Supply Units	碓基半導體股份有限公司 楊長暉 博士 Dr. Brian Yang
13:40-14:20	Advanced Power Modules for AI Applications	乾坤科技股份有限公司 電源模組事業處-副總經理 黎耀威 博士 Dr. Tyan Lai
14:20-14:40	Coffee Break	
14:40-15:10	The Opportunity of GaN on X Power Device in 800V HVDC Architecture for AI Datacenters	長庚大學電子系 邱顯欽 教授
15:10-15:40	SiC Power Devices for AI Infrastructure	碳矽電子股份有限公司 國立臺灣大學 李坤彥教授
15:40-16:00	會後交流	

掃碼報名

主辦單位：中央大學電機系

贊助單位：教育部深耕計畫-智慧科技與綠色循環

